

お問合せ先
OBARA GROUP株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10
TEL. 046-271-2124

適切に選別された森林からの原料を含むFSC®認証紙と環境に配慮した植物油インキを使用
して造ります。



www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第55期 報告書

2012年10月1日………2013年9月30日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2013年9月期における事業の概況等をご報告致します。

当期における世界経済は、米国において緩やかな景気回復が続いたものの、中国・インドを始めとする新興国の経済成長の鈍化や欧州地域の不透明な景況感の継続などから、全体として弱含みで推移しました。

我が国経済につきましては、依然として楽観できない状況が続いたものの、個人消費は底堅さを見せたほか、輸出型産業の業績向上など、明るい兆しが見られました。

そのような外部環境の中、溶接機器関連事業が自動車メーカーの米州及びアジア地域を中心とした活発な生産活動や設備投資による需要拡大への対応を継続的に展開したことと、平面研磨装置関連事業がエレクトロニクス業界の需給調整の中、顧客ニーズの発掘と迅速対応に注力したことなどにより、当社の業績は、営業・経常・当期純利益が、創業以来の最高益となりました。

なお、当期の利益配分につきましては、2013年8月26日に公表の通り、業績が順調に推移したことなどから、1株当たり期末配当金を当初予想より30円増配の40円(普通配当30円及び当期純利益が過去最高益となったことによる記念配当10

円)とし、年間配当金を50円(うち第2四半期末配当10円)とする案を2013年12月20日開催の定時株主総会に付議し、決議いたしました。

次期も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2013年12月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	



営業の概況

連結業績サマリー

(百万円)

	実績			次期(第56期)の見通し	
	前期(第54期)	当期(第55期)	前期比	期初計画	当期比
売上高	32,259	38,582	19.6%	39,000	1.1%
営業利益	4,469	6,280	40.5%	6,000	△4.5%
経常利益	4,604	7,343	59.5%	5,900	△19.7%
当期純利益	2,718	4,593	69.0%	4,000	△12.9%
1株当たり配当金	30円 ^(年間)	50円 ^(年間) 記念配当10円含む	20円	40円 ^(年間)	△10円

03

当期の連結業績について

溶接機器関連事業と深く関わる自動車業界では、米州及びアジア地域での自動車需要の拡大を背景として設備の増強と生産活動に活発な動きが見られました。一方、平面研磨装置関連事業と深く関わるエレクトロニクス業界では、エレクトロニクス製品の総体的な販売軟調を受け、設備投資及び生産活動は、落ち着いた状況が続きました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努めたことなどにより、両事業ともアジア地域を中心とした活動が好調に推移しました。この結果、当期の業績は、営業・経常・当期純利益が、創業以来の最高益となりました。

次期の見通しについて

当社グループと深く関わる自動車業界では、一部に小幅な調整が見込まれますが、新興国等の成長市場においては、総じて高水準の設備投資や生産活動が継続すると予想されます。また、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、中長期的な設備投資意欲は強いものの、関連商品の市場拡大が世界的に緩やかに進む中、足元の設備投資や生産活動については、着実ながらも市場実勢に応じた展開が予想されます。

そのような状況下、当社グループの次期業績は、当期と比較し落ち着いた状況に推移すると見通しておりますが、当社グループとしては、業績の向上に鋭意注力すべく、成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行ってまいります。また同時に、中長期的かつ持続的な成長を目指す、積極的な設備投資と研究開発を行ってまいります。

04

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

●溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

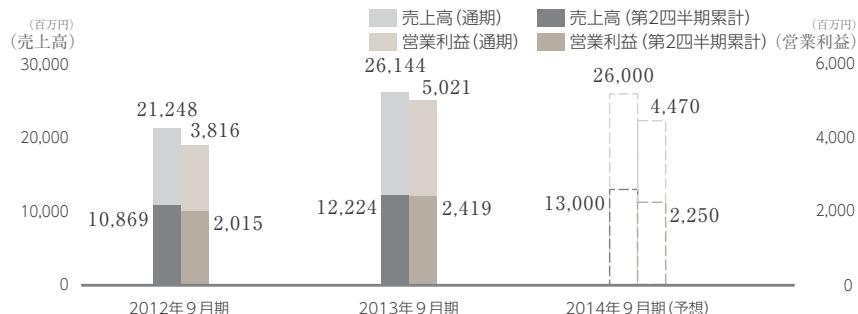
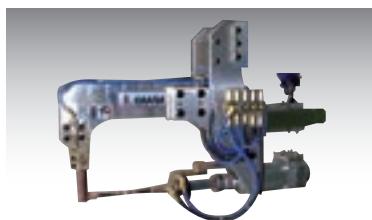
OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

溶接機器関連事業につきましては、取引先である日系・欧米系・アジア系自動車メーカーにおいて、アジア地域などで積極的な増産投資が行われ、世界各地の自動車生産は高水準となりました。このような環境の下、当事業として設備品の需要拡大への対応並びに消耗品の拡販に努めました。

この結果、当事業の売上高は261億44百万円(前期比23.0%増)となり、営業利益は50億21百万円(前期比31.6%増)となりました。

売上高構成比

38,582百万円……2013年9月期 売上高

平面研磨装置関連事業

溶接機器
関連事業

67.8%

セグメント別事業概況

平面研磨
装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

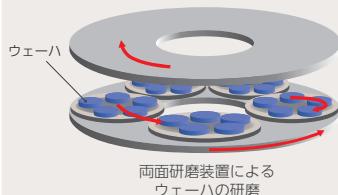
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載

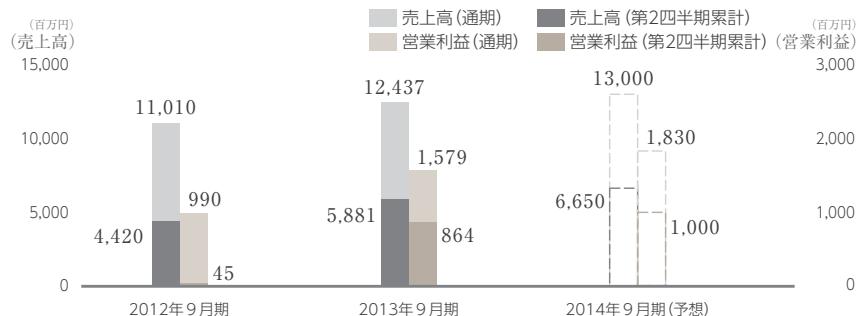


OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

平面研磨装置関連事業につきましては、パソコンなど主要エレクトロニクス製品の販売軟調を受け、当事業の取引先であるシリコンウェーハなどのエレクトロニクス関連素材において、設備投資及び生産活動は落ち着いた状況となりました。このような環境の下、当事業として顧客ニーズに適合した販売深耕を各業界へ図りました。

この結果、当事業の売上高は124億37百万円(前期比13.0%増)、営業利益は15億79百万円(前期比59.4%増)となりました。

売上高構成比

38,582 百万円……2013年9月期 売上高

溶接機器
関連事業

平面研磨装置関連事業

32.2%

トピックス

事業トピックス／溶接機器関連事業／上海工場の能力を増強

中国では、自動車の生産及び販売が堅調に推移しています。これは同国においてモータリゼーションが着実に進展していることが要因の1つと言われ、世界の自動車メーカー各社は中国市場向けの戦略を強化しており、生産設備の増強やローカルニーズに適した自動車の開発、市場への投入が積極的に行われています。

当社グループは、このような環境の下、溶接機器関連事業の上海工場において能力増強を開始しました。増大する自動車メーカー各社の製品ニーズに適時対応するため、次期第3四半期(2014年春)からの当増強設備の稼働を予定しています。これにより、上海工場の生産能力は、当期末と比べ、30%程度拡大する計画です。当社グループは、成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績の向上に努めてまいります。



OBARA上海

09

事業トピックス／平面研磨装置関連事業／METALEX 2013に出展

2013年11月、タイ・バンコクで開催された工作機械展示会「METALEX 2013」において、金属・セラミックス・ガラス・半導体など多様な加工物に対する当社グループの最新の取組みを紹介しました。市場拡大が続くアジア地域への製品販売を更に積極化していく考えの下、両面研磨装置の実機展示を含め、高生産性と高精度とを両立させる製造プロセスについて効果的なプレゼンテーションを行い、多くの来訪者の注目を集めました。

当社グループの平面研磨装置関連事業は、シリコンウェーハなどエレクトロニクス業界を主要なマーケットとしておりますが、その他の産業向けアプリケーションに対しても活躍の場を拓げるべく、ラインナップの充実に引き続き注力していきます。各種産業の日々高度化する平坦化要求に、一歩先に進んだソリューションを提供することにより、事業の発展に繋がりたいと考えています。

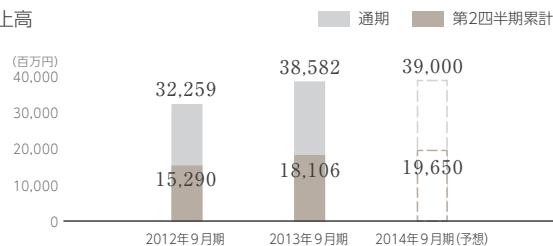


METALEX 2013

10

主要経営指標の推移

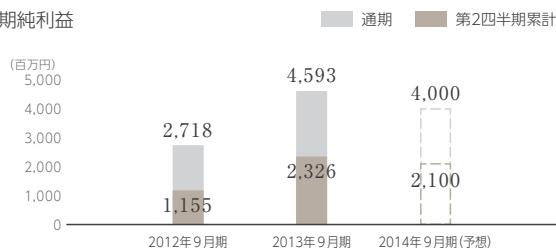
売上高



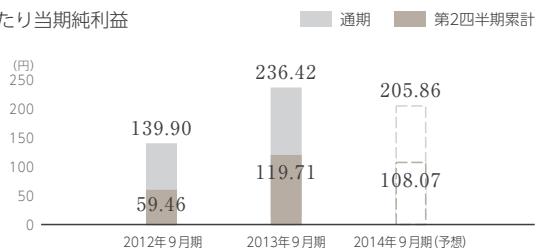
経常利益



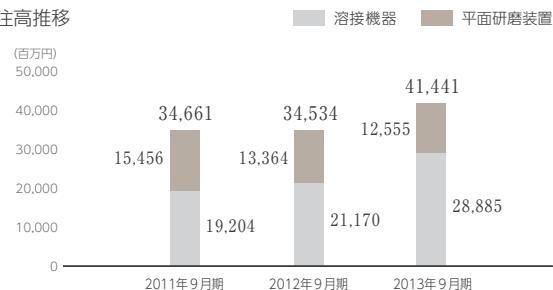
当期純利益



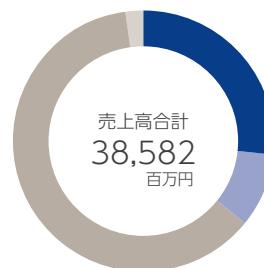
1株当たり当期純利益



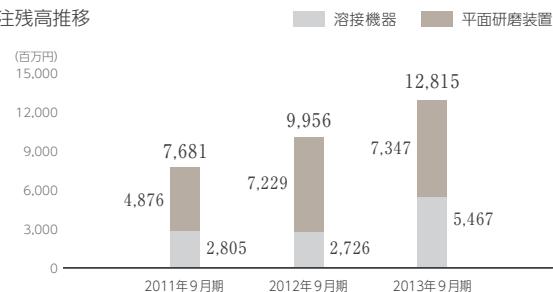
受注高推移



地域別売上高構成比



受注残高推移

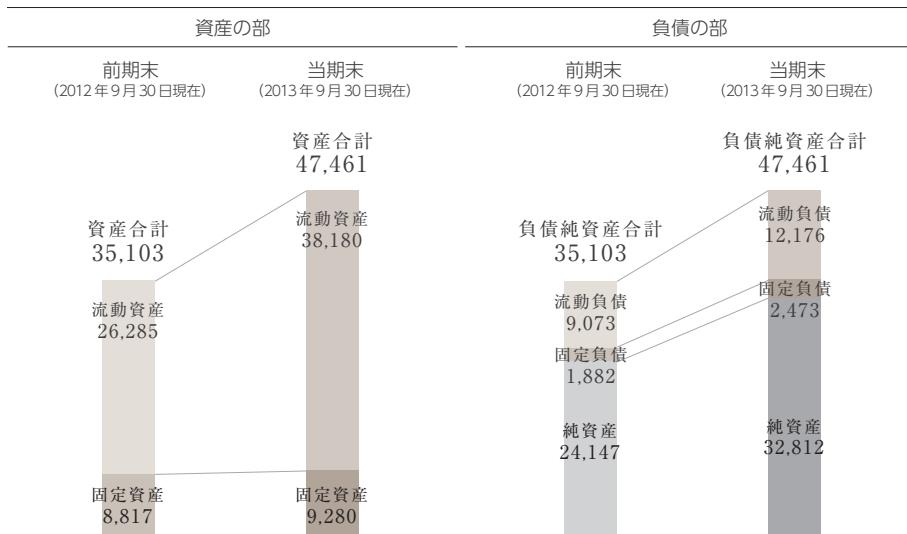


(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

連結財務データ

資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



資産負債

point
1

総資産は474億61百万円と、前期末に比べて123億58百万円増加しました。現金及び預金が58億74百万円、受取手形及び売掛金が36億93百万円増加したことなどによります。負債は、146億49百万円と、前期末に比べて36億93百万円増加しました。支払手形及び買掛金が16億93百万円、前受金が18億84百万円増加したことなどによります。

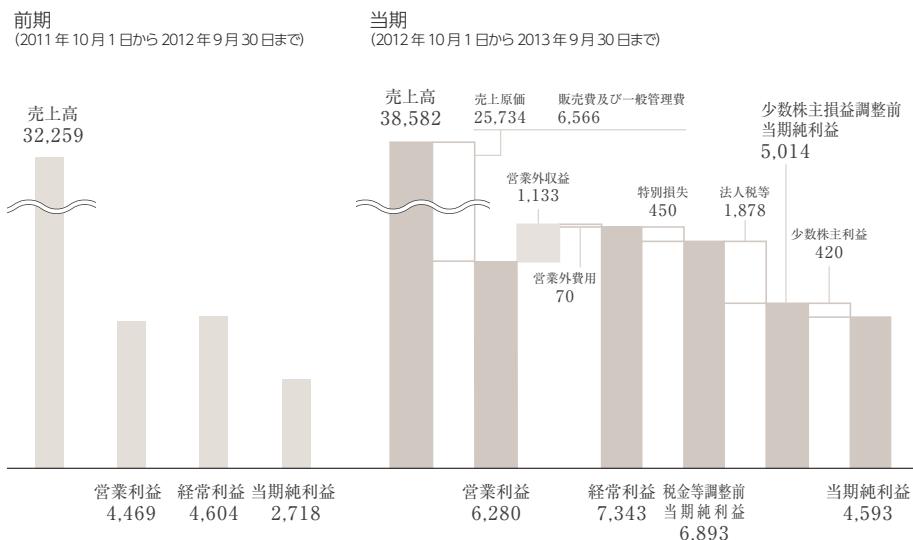
point
2

純資産

純資産は328億12百万円と、前期末に比べて86億64百万円増加しました。利益剰余金が40億11百万円、少数株主持分が6億44百万円、円安により為替換算調整勘定が37億83百万円増加したことなどによります。

損益の状況

(単位：百万円)



point
3

売上高・営業利益・経常利益・当期純利益

連結売上高385億82百万円(前期比19.6%増)、営業利益62億80百万円(前期比40.5%増)、経常利益は、為替差益7億45百万円を含む73億43百万円(前期比59.5%増)、当期純利益は、特別損失に減損損失4億50百万円を計上したことなどから45億93百万円(前期比69.0%増)となりました。

point
4

営業外収支・特別損失

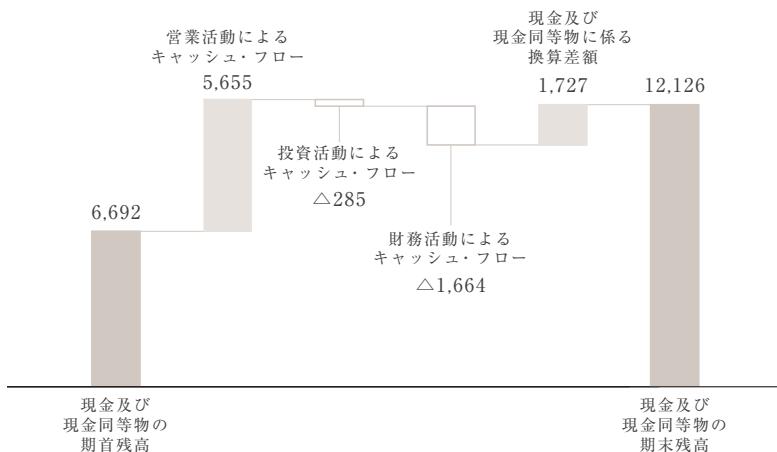
受取利息1億47百万円、為替差益7億45百万円と営業外収益が11億33百万円となった一方、支払利息39百万円など、営業外費用が70百万円となりました。

連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当期
(2012年10月1日から2013年9月30日まで)

(単位：百万円)



point
5

営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、56億55百万円となりました。税金等調整前当期純利益が68億93百万円、前受金の増加額が12億68百万円などとなった一方、売上債権の増加額が14億95百万円、たな卸資産の増加額が12億78百万円、法人税等の支払額が16億22百万円発生したことなどによります。

point
6

投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により支出したキャッシュ・フローは2億85百万円となりました。投資有価証券の売却及び償還による収入が34百万円となった一方、有形固定資産の取得による支出が3億30百万円、投資有価証券の取得による支出が2億14百万円発生したことなどによります。

point
7

財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出したキャッシュ・フローは16億64百万円となりました。短期借入金の純減少額が9億36百万円、配当金の支払額が5億83百万円発生したことなどによります。

会社情報

会社概要

(2013年9月30日現在)

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	1,925,949,120円
従業員数	22名(連結 1,688名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間 3-2-10 046-271-1111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

(2013年12月20日現在)

取締役社長	小原 康嗣
取締役	小林 憲史
取締役	周澤 健
取締役	山下 光久
常勤監査役	谷内 博
社外監査役	大西 倫雄
社外監査役	村松 建夫

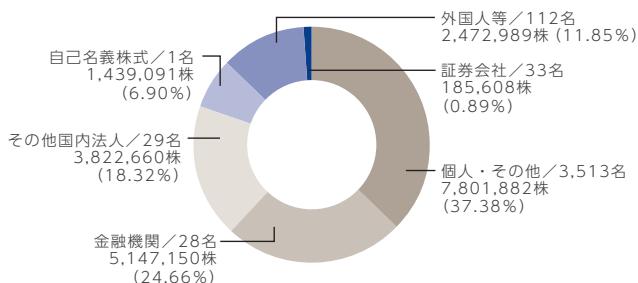
(注) 監査役のうち、大西倫雄及び村松建夫の両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。

株式情報 (2013年9月30日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	3,716名

株主分布状況



大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社馬込興産	3,703	19.06
小原 康嗣	2,261	11.63
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	1,313	6.75
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	1,075	5.53
DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-TREATY CLIENTS 613	680	3.50
野村信託銀行株式会社(投信口)	406	2.09
株式会社三菱東京UFJ銀行	369	1.90
NORTHERN TRUST CO. (AVFC)SUB A/C AMERICAN CLIENTS	329	1.69
小原 博	310	1.59
小原 範子	304	1.56

- (注) 1. 上記のほか、自己株式1,439千株を保有しております。
 2. 持株比率は、自己株式1,439千株を控除して計算しております。
 3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数774千株を加えて表示しております。

株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月
基準日	定時株主総会の議決権 毎年9月30日 期末配当 毎年9月30日 第2四半期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

株主名簿管理人	〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所 (郵便物送付先 お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル)

同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

公告方法 当社公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。
<http://www.obara-g.com/>
 但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行なうことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。